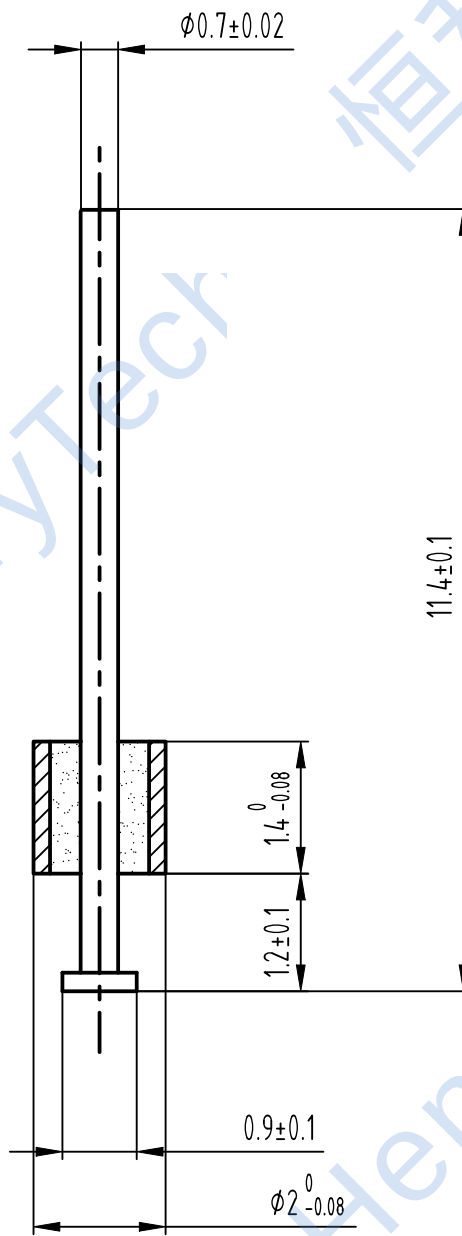




- 技术要求：
- 1. 绝缘电阻： $\geq 5000\text{M}\Omega @ 500\text{V}$
 - 2. 介电耐压： $\geq 300\text{V}$
 - 3. 密封漏率： $\leq 1.013 \times 10^{-3} \text{Pa} \cdot \text{cm}^3/\text{S}$
 - 4. 使用寿命： ≥ 500 次
 - 5. 温度范围： $-65 \sim +155$
 - 6. 镀层厚度： $\geq 1.27 \mu\text{m}$ 软金

借通用件登记
描 图
校 描
旧底图总号
签 字
日 期

						装 配 图		
	标记	处数	更改文件号	签字	日期	图样标记	重量	比例
	设计	M.		标准化				11:1
	审核							
	工艺							

HN-DC2014-0.7(11.4-1.2)-T0.9

成都恒利泰科技有限公司

 成都恒利泰科技有限公司
Chengdu HenryTech Technology co., Ltd